

PRODUCT CHANGE NOTICE

PCN 编号	PCN20191210-001	发行人：张姚	发行日期：2019/12/10
客户名称	ALL	联系人：NA	

受影响产品	商业名称	规格型号	备注
ALL	ALL	ALL	华大 MCU 芯片的各封装形式印章格式均变更

变更原因描述	优化封装印章排版，提升 Pin1 识别度。
--------	-----------------------

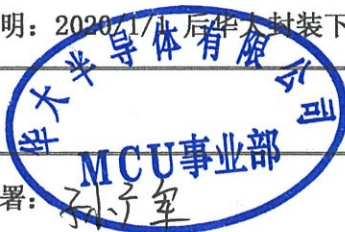
变更方法描述	<p>华大 MCU 芯片封装印章改版前后的示意图对比如下：</p> <p>备注：示意图中虚线框内为印章信息预留位，打印内容不固定。</p> <p>1. TSSOP 类封装：</p>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">封装形式</th> <th colspan="2">示意说明图</th> </tr> <tr> <td></td> <th style="width: 45%;">华大（当前）</th> <th style="width: 45%;">华大(改版后)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSSOP14/16</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TSSOP20</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TSSOP28</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		封装形式	示意说明图			华大（当前）	华大(改版后)	TSSOP14/16			TSSOP20			TSSOP28		
封装形式	示意说明图																
	华大（当前）	华大(改版后)															
TSSOP14/16																	
TSSOP20																	
TSSOP28																	
	<p>2. QFN 类封装</p>																

		示意说明图	
封装形式	华大 (当前)	华大(改版后)	
QFN 3*3 QFN 4*4	<p>Pin1 商业编号 (第1~8位) → PN 商业编号 (第9~12位) → PN Lot No (8位) → Lot No.</p>	<p>Pin1 Revision Code 商业编号 (第5~12位) → PN Lot No (8位) → Lot No.</p>	
QFN 5*5	<p>Pin1 商业编号 (第1~8位) → PN 商业编号 (第9~12位) → PN Lot No (8位) → Lot No.</p>	<p>Pin1 Revision Code 商业编号 (第5~12位) → PN Lot No (8位) → Lot No. Date Code (6位) → Date Code</p>	
QFN 6*6 QFN 7*7	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~12位) → PN Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No.</p>	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~8位) → PN 商业编号 (第9~12位) → PN Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No. Revision Code</p>	

3. QFP 类封装

		示意说明图	
封装形式	华大 (当前)	华大(改版后)	
QFP 7*7	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~10位) → PN Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No.</p>	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~8位) → PN 商业编号 (第9~12位) → PN Revision Code Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No.</p>	
QFP 10*10 QFP 12*12 QFP 14*14	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~12位) → PN Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No.</p>	<p>Pin1 华大Logo 商业编号 (第1~8位) → PN 商业编号 (第9~12位) → PN Revision Code Date Code (6位) → Date Code Lot No (8位) → Lot No.</p>	

变更生效日期或产品 Date Code 说明：2020/1/1 后华大封装下单的芯片物料，统一使用改版后的印章格式



华大半导体 MCU 事业部工程经理签署：孙行军

日期：2019.12.11

客户 _____ 部确认意见：

签署：

日期：